

[홈페이지 게재용]

Investor Relations – 2019.2Q

Envision your future, Beyond technology



soulbrain

본 자료의 재무정보 및 손익정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성한 연결재무제표입니다.

본 자료에 기재되어 있는 향후 전망은 당사가 속해 있는 시장 상황 및 경영 방향 등을 고려한 것으로서, 시장 상황의 변화와 경영 방향의 수정에 의하여 변동 될 수 있습니다.

본 자료는 투자자들의 추정이나 투자 판단의 자료로서 이용될 수 있으나 이에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로써 사용 될 수 없음을 알려드립니다.

CONTENTS OF IR REPORT

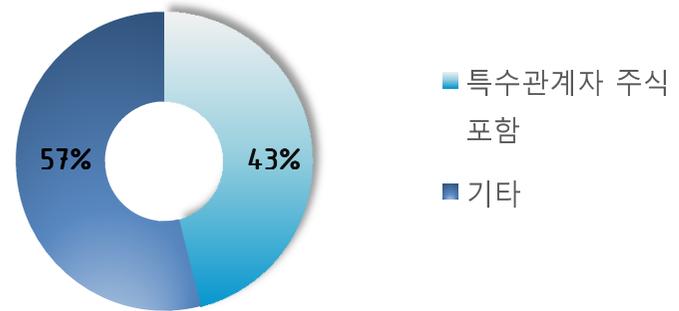
회사개요	▪ Page 3
사업개요	▪ Page 4
요약 연결손익계산서	▪ Page 5
요약 연결재무상태표	▪ Page 6
반도체	▪ Page 7
디스플레이	▪ Page 10
이차전지	▪ Page 13
Financial Highlights	▪ Page 14
계열회사	▪ Page 15
연결포괄손익계산서	▪ Page 16
연결재무상태표	▪ Page 17

회사 개요

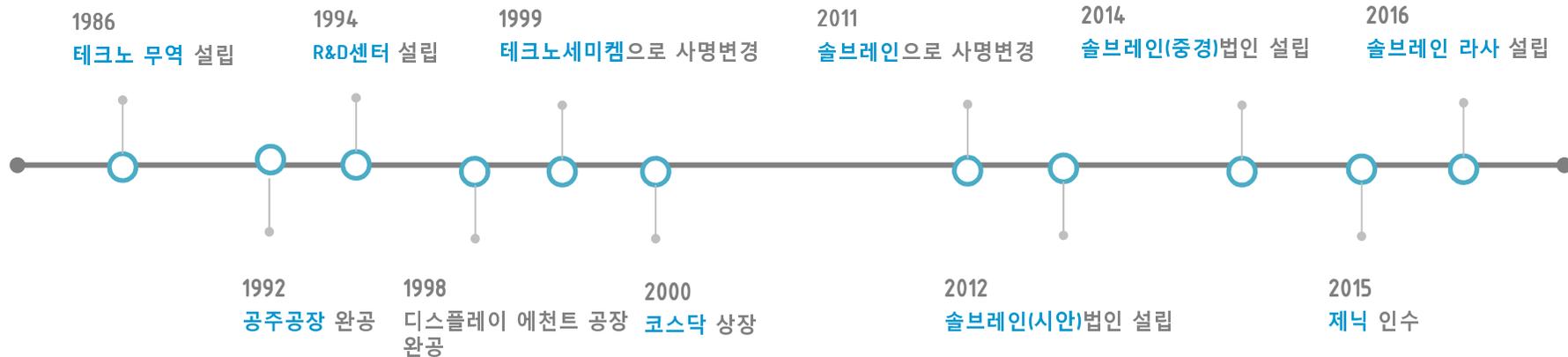
- 대표 : 강 병 창
- 설립일자 : 1986년 5월
- 시가총액(17년 12월 기준) : 약 1조원
- 임직원 수: 1,100명 (R&D staffs 150명)
- 본사: 성남시 분당구 판교로 255번길 34
- 연구소(국내) : 공주, 파주, 판교중앙, 신갈



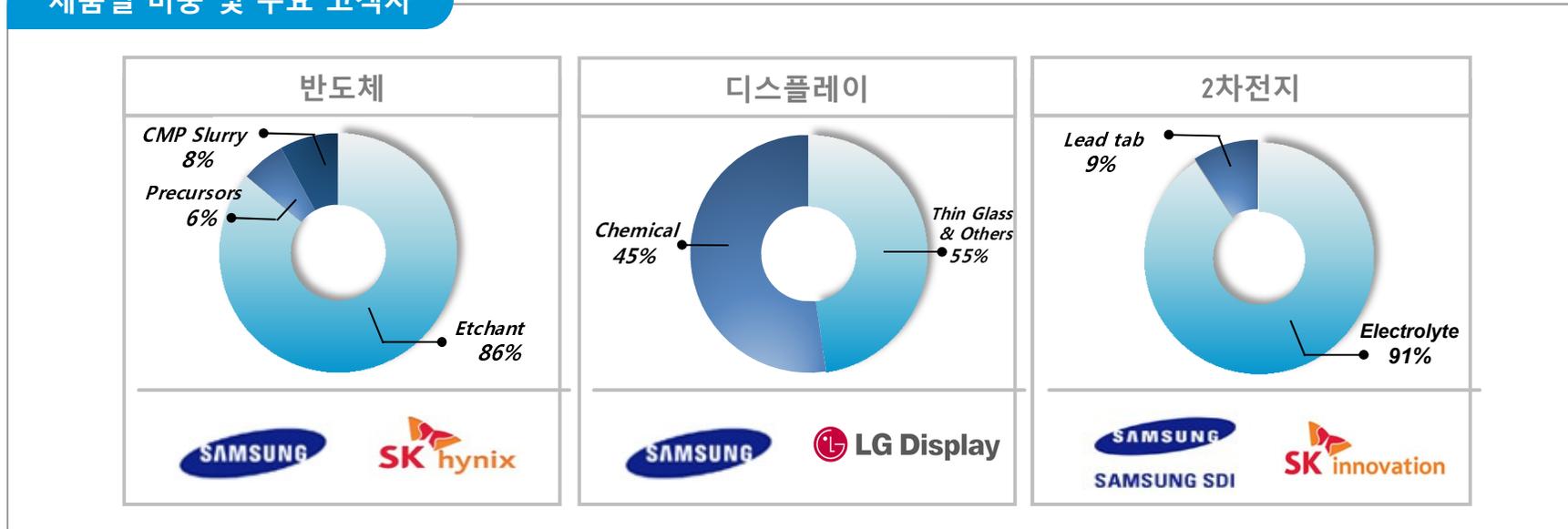
주주 현황



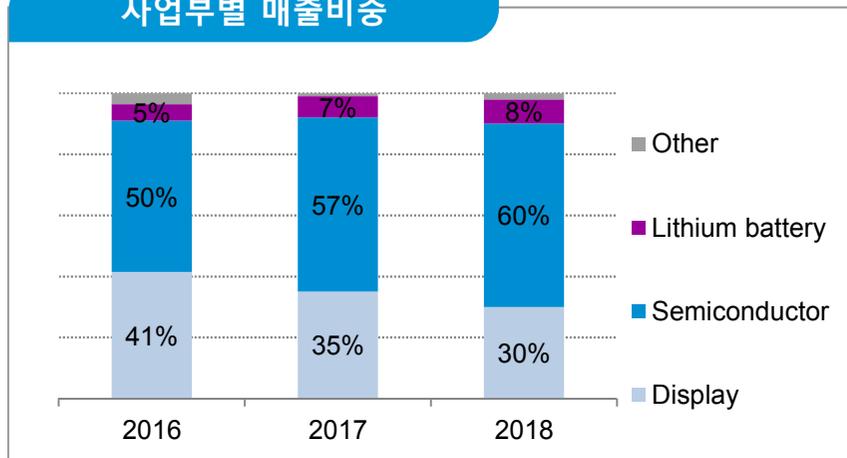
회사 연혁



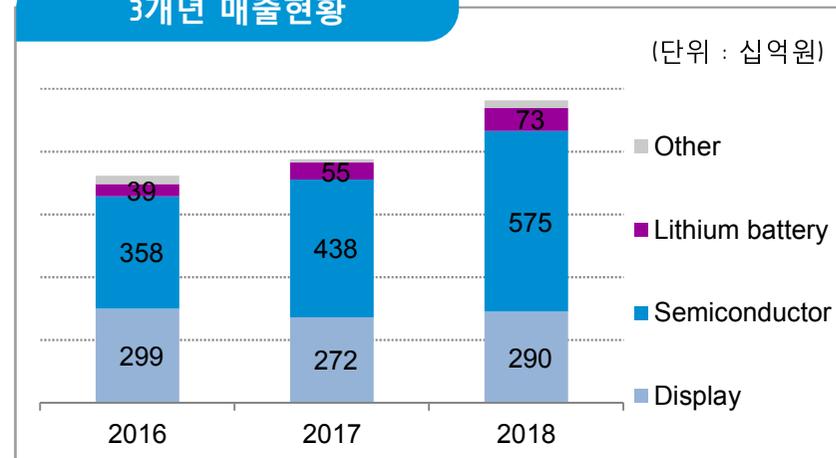
제품별 비중 및 주요 고객사



사업부별 매출비중



3개년 매출현황



(단위 : 백만원)

구 분	2Q19	1Q19	QoQ	2Q18	YoY
매출액	256,691	246,848	4%	238,256	8%
매출총이익	68,649	60,343	14%	60,726	13%
영업이익	45,810	43,060	6%	43,197	6%
법인세비용차감전순이익	53,443	56,628	-6%	36,261	47%
순이익	40,135	43,107	-7%	24,101	67%

손익분석

▪ 매출액 및 영업이익

✓ 영업이익 6% 상승(QoQ)

▪ 순이익

✓ 순이익(세후) -7% 감소(QoQ)

✓ 계열사 손상차손 등 반영

(단위 : 백만원)

구 분	2Q19	1Q19	QoQ	2Q18	YoY
유동자산	456,075	445,012	2%	348,618	31%
비유동자산	623,641	598,394	4%	547,457	14%
자산총계	1,079,716	1,043,406	3%	932,075	16%
유동부채	253,157	258,091	-2%	219,289	15%
비유동부채	19,661	18,395	7%	13,124	50%
부채총계	272,818	276,486	-1%	232,413	17%
자본총계	806,897	766,920	5%	699,662	15%

재무 분석

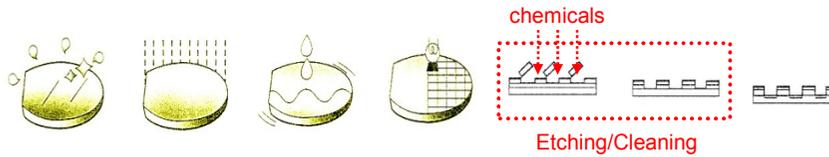
■ 자산 및 부채

- ✓ 전기대비(QoQ) 자산 2% 상승
- ✓ 전기대비(QoQ) 부채 1% 감소

Key Points

▪ HF, B.O.E(Buffered Oxide Etchant) 등

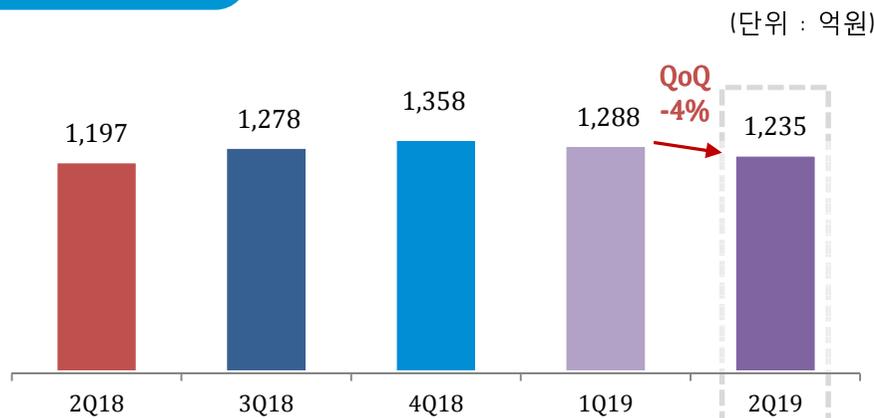
- HF & B.O.E : 반도체 공정 etching 및 cleaning에 사용되는 화학약품
- 원재료 내재화에 따른 경쟁력 강화 : 불화암모늄, 무수불산



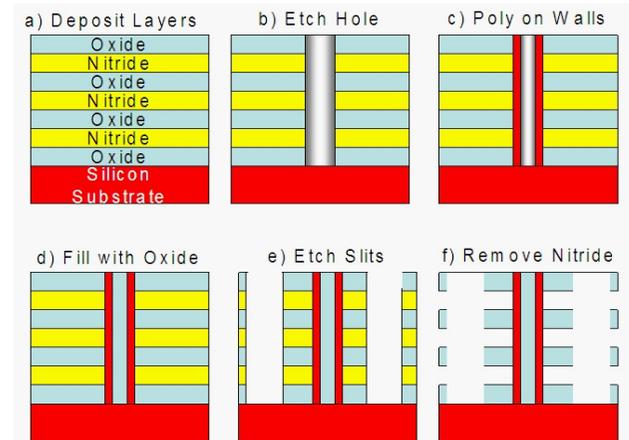
▪ 반도체 업체의 안정적인 생산 기대

- 주요 반도체 고객사 지속적인 라인 증설 수혜
- 공정변화에 따른 제품 대응 : pattern 미세화 & Process 복잡화, 고기능성 식각액 필요성 증대

Sales Trend



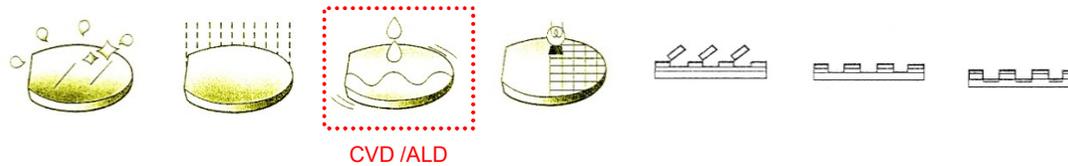
Etching/Cleaning Process in 3D-NAND



Key Points

■ CVD(Chemical Vapor Deposition), ALD(Atomic Layer Deposition) 재료

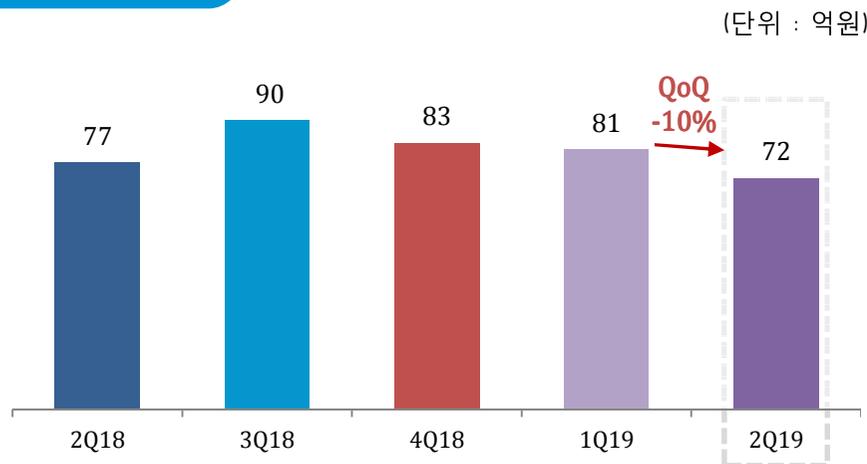
- 화학물질을 플라즈마 등을 이용 웨이퍼 위에 반응시켜 박막을 형성시키는 '박막 증착 공정'에 사용되는 전극재료(High-K), 저유전체(Low-K) 등
- 공정 미세화에 따라 신규 제품에 대한 수요 증대



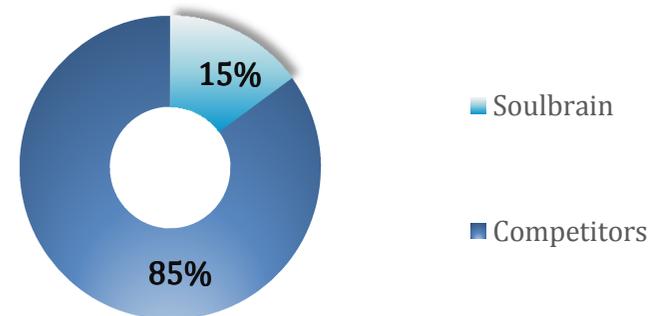
■ 신규 제품을 통한 매출 증가 기대

- 미세화, 고기능화에 적합한 차세대 신규 물질 지속 개발

Sales Trend



Market Share



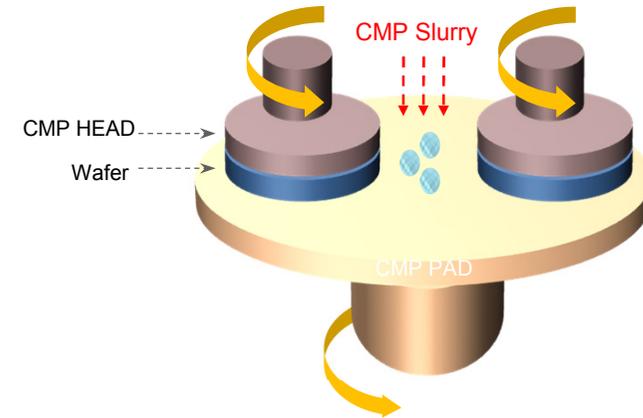
Key Points

■ CMP(Chemical Mechanical Polishing) Slurry

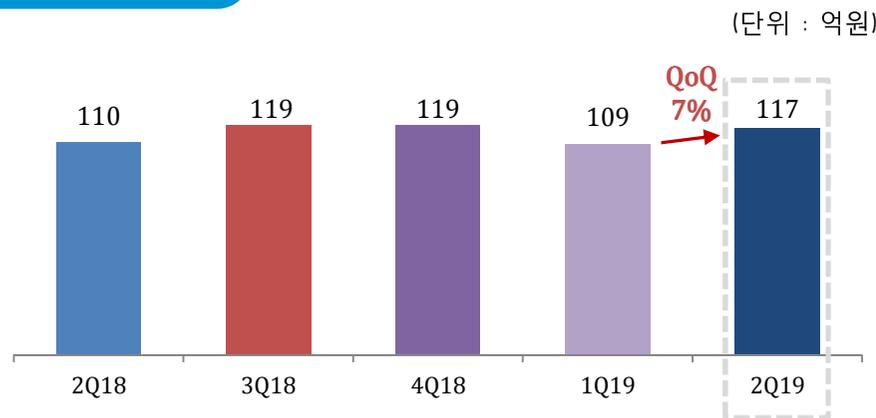
- 반도체 박막 평탄화를 위한 연마 재료
: 연마 대상 막질에 따라 Ceria, W, Cu Slurry 등으로 구분됨
- 반도체 공정 미세화에 따라 수요 증가

■ 고객사 확대 노력 지속

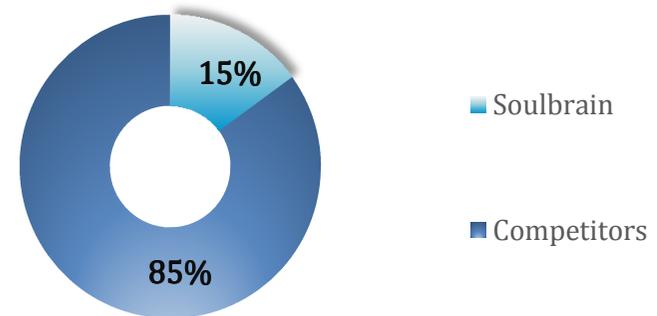
- Ceria Slurry 점유율 확대노력 지속
- 신규 Slurry 확대 노력 (Cu Slurry, W Slurry 신규 공급 기대)



Sales Trend



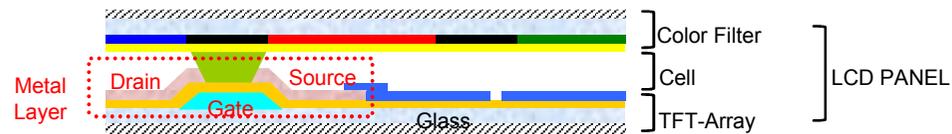
Market Share



Key Points

Etchant(식각액)

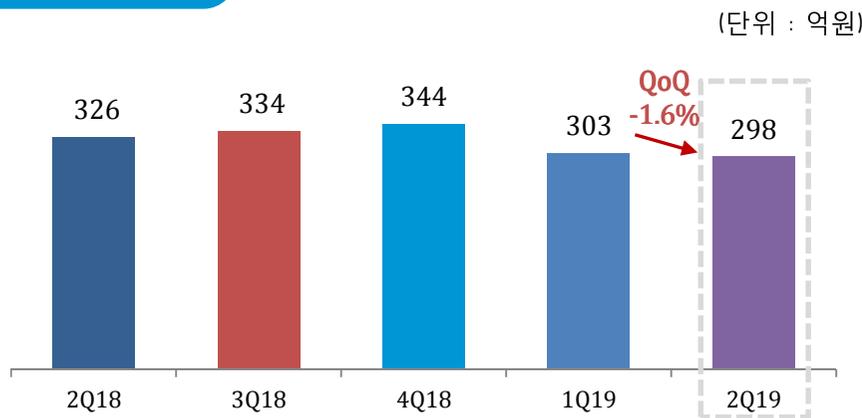
- 패턴을 형성하기 위하여 금속 배선의 필요하지 않은 부분을 선택적으로 제거하는 etching공정에 사용되는 화학 약품



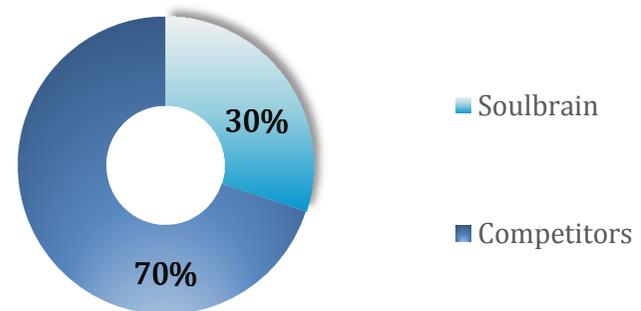
기술 변화에 대한 대응

- O.L.E.D 시장 확대 : TFT-LCD와 유사한 O.L.E.D etching 공정

Sales Trend

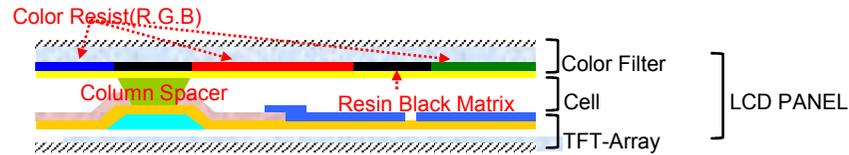


Market Share (Al, Cu Etchant)



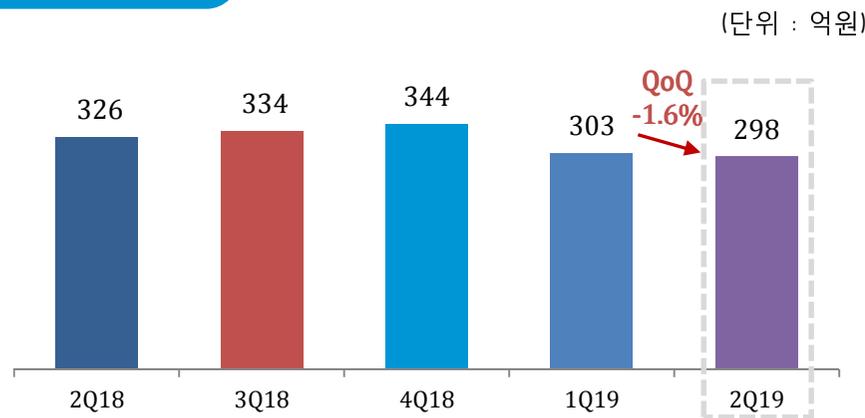
Key Points

- 유기재료 : Black Matrix, Black Column Spacer, Color Resist 외**
 - B.M : R.G.B 사이에서 빛의 투과를 막기 위하여 사용되는 유기 박막층
 - Black Column Spacer : TFT-LCD기판 사이의 간격을 유지시켜 주는 감광성 액체

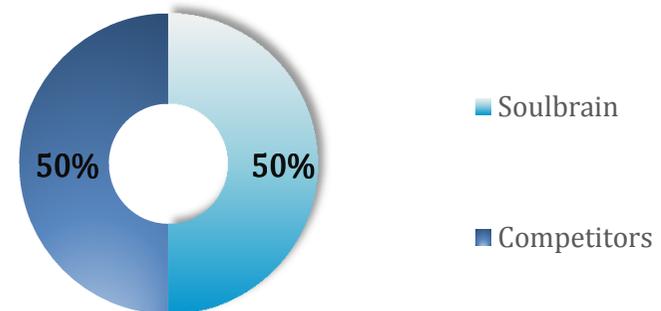


- 공급 제품 확대 노력**
 - R.B.M → Column Spacer로 제품 확대 및 점유율 확대 노력
 - J/V(솔브레인 50 : 미쯔비시 화학 50) 역할 강화 : 연구, 제품 및 원재료 생산

Sales Trend



Market Share (B.M & B.C.S)



Key Points

■ Thin Glass / Scribing(soulbrain SLD)

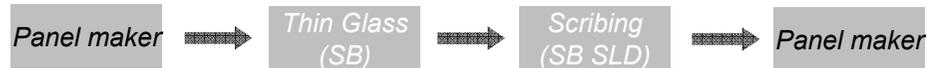
- Thin Glass : 화학적 방식(etching)으로 glass 두께 축소
- Scribing : 물리적 방식으로 패널을 셀 사이즈에 맞게 절단

■ 스마트폰 등 관련 제품 생산량과 연동

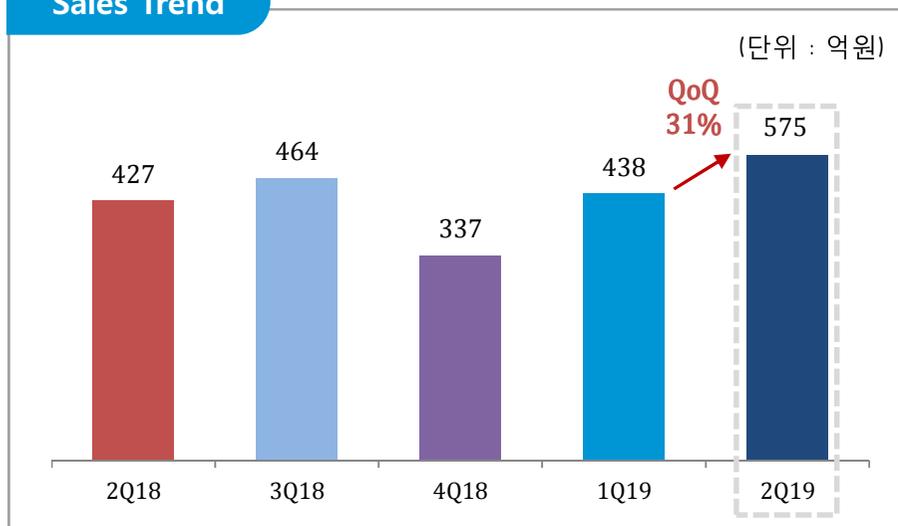
- 모바일 기기 필수 공정 : 두께, 무게 등이 중요한 모바일 기기에 적합
- Rigid type 수요에 따른 생산량 변동

■ Thin Glass 선두 업체로서 안정적 시장점유율 유지

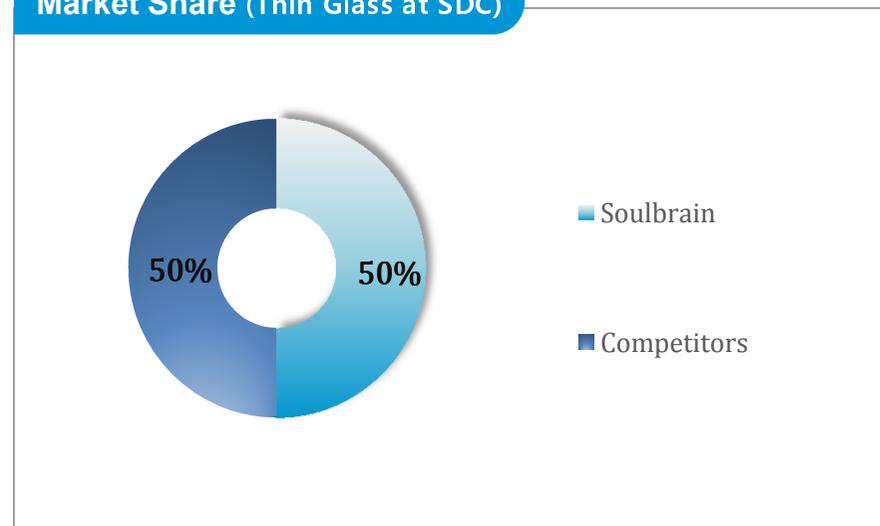
- T.G와 자회사 솔브레인SLD의 Scribing 일괄 진행으로 공정 효율성 확보



Sales Trend



Market Share (Thin Glass at SDC)



Key Points

■ 2차 전지 전해액 / Lead Tab

- 전해액 : 음극과 양극 사이의 원활한 이동을 유도하는 화학 혼합물
- Lead Tab : 전지에서 발생한 에너지를 device로 전달하는 역할

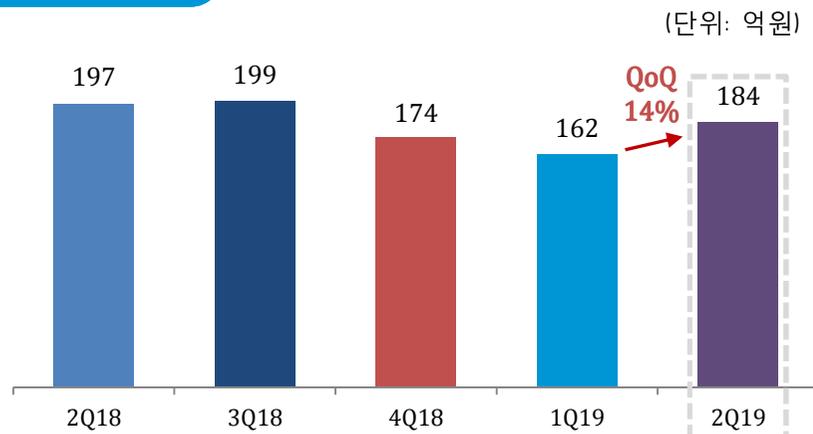
■ IT용 2차 전지 시장의 안정적 성장

- 2차 전지 필수 소재
- IT용 전지 수요의 지속적 증가 : 스마트폰, 태블릿 PC 등

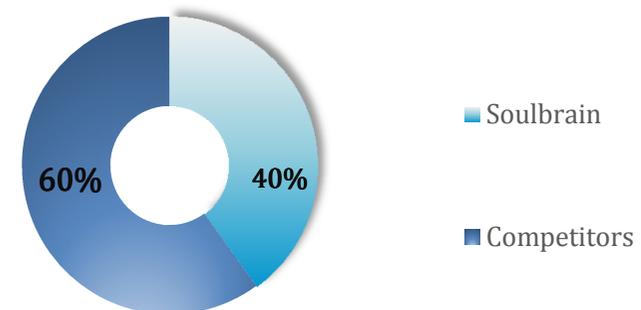
■ E.V 등 대용량 2차 전지 시장의 본격화 기대

- 전지 업체와의 공동기술개발 등 진행
- 한국, 미국, 말레이시아 3개 지역 생산 시설 보유

Sales Trend

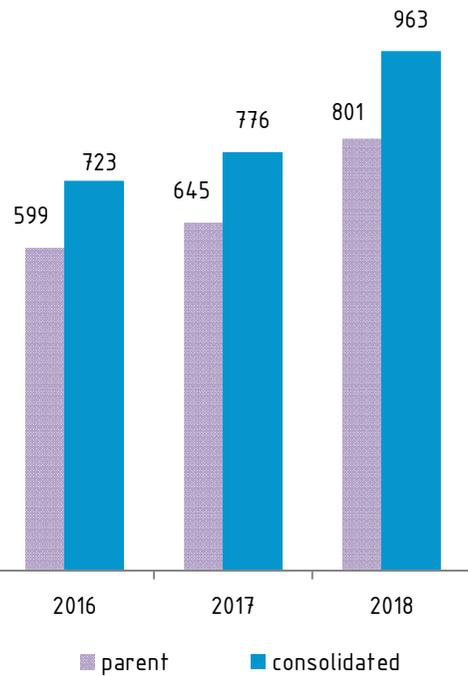


Market Share (In Samsung SDI)



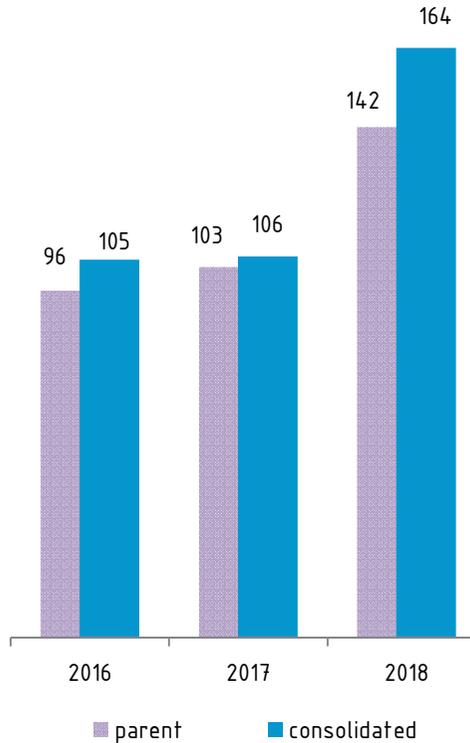
매출액

(단위: 십억원)



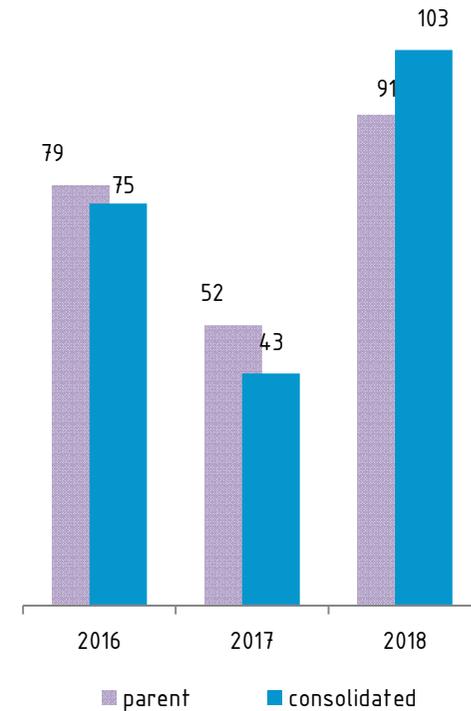
영업이익

(단위: 십억원)



당기순이익

(단위: 십억원)



반도체 계열회사

회사명	주요사업	지분율
훅트	HF, B.O.E	49%
솔브레인 시안	중국생산법인	100%
솔브레인 라사	고순도인산	51%
솔브레인 멤시스	반도체장비	100%
프로웰	프로브 핀	30%

디스플레이 계열회사

회사명	주요사업	지분율
솔브레인 에스엘디	Scribing 임가공	100%
솔브레인 옵토스	광학필름 임가공	99%
엠씨솔루션	Resin Black Matrix 외	50%
솔브레인 중경	Etchant	100%

이차전지 계열회사

회사명	주요사업	지분율
솔브레인 MI	전해액	100%
솔브레인 E&I Malaysia	전해액	100%

기타 계열회사

회사명	주요사업	지분율
나우아이비캐피탈	기업인수자문 외	33%
솔브레인저축은행	저축은행업	48%
제닉	마스크팩 외	25%
비즈네트웍스	전자상거래 및 통신 판매업	70%
유니머스홀딩스	금융투자업	30%
라이프시맨틱스	의료정보연구개발	16%
나우2호 기업재무안정 사모투자 합자회사	PEF	44%
ARK Diagnostics	의료기기개발생산	40%

(단위: 백만원)

구 분	2017	2018	1Q2019
매출액	775,598	963,425	246,848
매출 원가	604,370	725,796	186,505
매출총이익	171,228	237,628	60,343
판매관리비	65,534	73,556	17,283
영업이익	105,694	164,072	43,060
기타수익	9,725	20,330	6,857
기타비용	28,126	22,269	2,767
금융수익	5,693	10,077	4,345
금융비용	19,558	6,205	1,834
지분법이익	10,867	11,167	8,492
지분법손실	5,233	7,757	1,525
관계회사투자주식처분손익	253	2,262	-
관계회사투자주식손상차손	12,557	25,040	-
법인세비용차감전 순이익	66,759	146,637	56,628
법인세 비용	23,673	43,681	13,521
당기순이익	43,086	102,957	43,107

(단위: 백만원)

구분	2017	2018	1Q2019
유동자산	377,457	413,233	445,012
비유동자산	518,493	592,887	598,394
자산총계	895,950	1,006,120	1,043,406
유동부채	232,825	253,482	258,091
비유동부채	13,266	18,850	18,395
부채총계	246,091	272,332	276,486
자본금	8,699	8,699	8,699
주식발행초과금(자본잉여금)	133,947	133,947	133,947
자기주식(자본조정)	-11,676	-16,678	-16,678
기타잉여금	55	-2,812	-132
이익잉여금	513,973	602,362	631,970
비지배지분	4,861	8,269	9,115
자본총계	649,859	733,788	766,920